

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年9月17日(2009.9.17)

【公開番号】特開2009-44065(P2009-44065A)

【公開日】平成21年2月26日(2009.2.26)

【年通号数】公開・登録公報2009-008

【出願番号】特願2007-209696(P2007-209696)

【国際特許分類】

H 05 K	1/09	(2006.01)
H 01 L	21/3205	(2006.01)
H 01 L	23/52	(2006.01)
H 01 L	25/065	(2006.01)
H 01 L	25/07	(2006.01)
H 01 L	25/18	(2006.01)
H 05 K	1/11	(2006.01)
H 01 L	23/12	(2006.01)
H 01 B	13/00	(2006.01)

【F I】

H 05 K	1/09	A
H 01 L	21/88	M
H 01 L	21/88	J
H 01 L	25/08	Z
H 05 K	1/11	N
H 01 L	23/12	N
H 01 B	13/00	5 0 3 D

【手続補正書】

【提出日】平成21年7月31日(2009.7.31)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

50wt%以上のビスマス(Bi)と、30wt%以下のインジウム(In)と、30wt%以下の錫(Sn)と、1~5wt%の範囲で選択された銅(Cu)とからなる粉体混合物である。

基板配線用の導電性組成物。

【請求項2】

基板に設けられた孔を埋める電極を有する回路基板であって、前記電極は、請求項1に記載された導電性組成物を用いて得られたものである、回路基板。

【請求項3】

基板に設けられた孔を埋める電極と、回路パターンとを有する回路基板であって、前記電極は、請求項1に記載された導電性組成物を用いて得られたものであり、

前記回路パターンは、前記電極と同一の導電性組成物で前記基板の少なくとも一面上に、前記電極と連続して同体に形成されたものである、

回路基板。

【請求項4】

請求項 2 又は 3 に記載された回路基板であって、前記基板は複数で、それぞれの基板は順次に積層されており、そのうちの少なくとも 1 層は、前記回路パターン及び前記電極を含んでいる、回路基板。

【請求項 5】

回路基板と、回路機能部とを有する電子デバイスであって、
前記回路基板は、請求項 2 乃至 4 の何れかに記載されたものであり、
前記回路機能部は、前記回路基板と組み合わされている、
電子デバイス。

【請求項 6】

請求項 5 に記載された電子デバイスであって、センサー モジュール、光電気モジュール、
F E T、M O S - F E T、C M O S - F E T、メモリーセル、F C (Field Complementary
)もしくは集積回路素子又はこれらのチップである、電子デバイス。